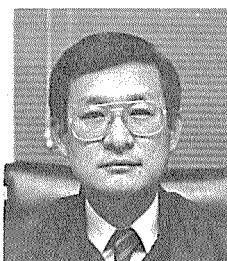


# 美・日 半導体摩擦 그 이후와 技術開発 動向



朴 光 五

現代電子産業(株) 半導体研究所長 専務理事/工博

미·일 반도체 마찰은  
그 波高가 전산업으로, 또  
선진국에서 NICs로 파급되고  
있어 기술력의 수반없이 성장을  
기대할 수 없음을 우리에게 강하게  
시사하고 있다. 그러나 반도체 산업의  
기술개발은 중장기적으로 추진해야  
하며 특히 업체간·산학간·  
관민간의 협력체제가  
강화되어야만  
하는 것이다.

## 1. 美・日 半導体 摩擦

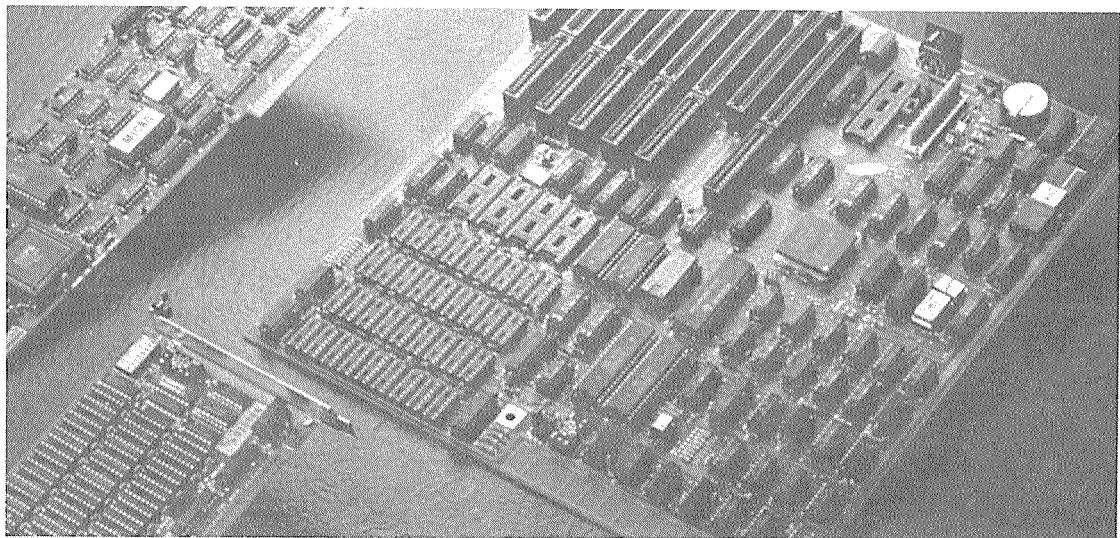
'80年代 들어 강화되고 있는 保護貿易主義, 즉 新貿易主義는 周知되고 있는 바와 같이 各国의 報復關稅 장벽의 강화와 報復警告의 형태로 나타나고 있으며 이로 因해 世界貿易秩序도 再編이 예상되고 있다. 다시 말해, 貿易摩擦은 紛爭으로, 紛爭은 戰爭이라고 생각할 수 있을 정도로 확대되고 있는 실정으로 그 波高는 尖端製品에서 全產業으로, 先進國에서 新興工業國家인 우리나라에까지 파급되고 있다.

최근의 이와 같은 貿易摩擦의 대표적인 事例는 世間에 잘 알려진 「美・日 半導体 摩擦」이다. 「美・日 半導体 摩擦」은 日本製 半導体의 美国市場 장악과 美国業體의 主導權 상실에 의해 勃發하게 되었다. 美・日間의 半導体 摩擦은 美国의 日本電子製品에 対한 100%의 貿易關稅 賦課 등으로 發展하게 되었는데 그 과정을 요약해 보면 다음과 같다.

즉, 日本의 半導体 産業은 70年代부터 汎用 모스 메모리(MOS Memory)를 중심으로 84年初까지 高度成長을 거듭해 왔으며, 技術力 (특히 量產技術)의 향상으로 80年初까지 美国이 쥐고 있던 世界 半導体 市場의 主導權을 차지하였다. 특히 82년에 日本이 256K DRAM을 世界最初로 開發하면서, 日本의 对美国 半導体 技術優位가 뚜렷해졌는데 256K DRAM의 86年 需要를 보면, 日本이 전체의 91.3%를 차지하여 市場을 독점하였다.

한편, 86年的 世界 半導体市場 占有率을 보면, 日本이 38.3%, 美国이 37.0%로 日本이 美国을 앞서기 시작하였고, 世界 10大 業體中 過半數를 占하였다. <表 1 參照>

이같은 日本 半導体 産業의 급속한 成長은 民間部門 마케팅에 重點을 두어 量產技術을 탄탄하게 확보함으로써, 價格競爭에서 優位에 설 수



보호무역주의 차원에서 야기된 美·日 반도체 마찰은 급기야 세계무역질서의 재편을 예상케 하고 있다.

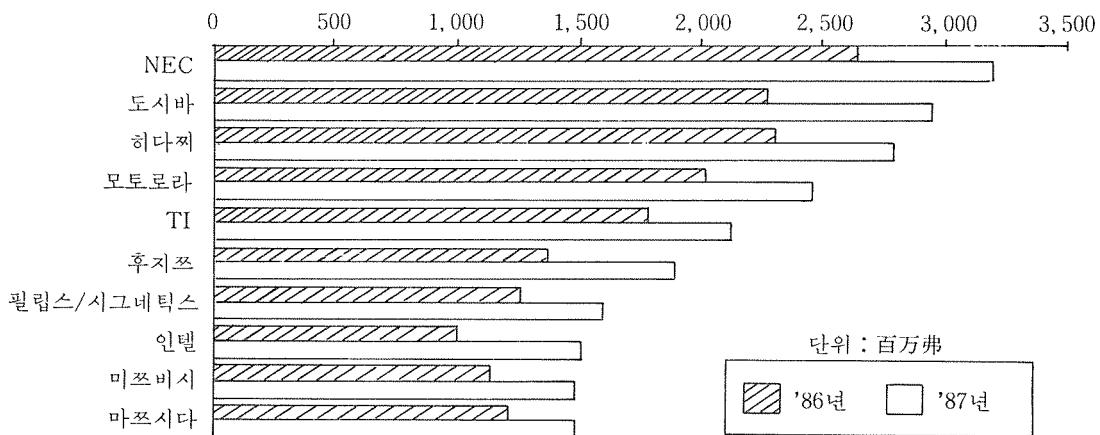


表 1. 世界半導体 10大 業體

業體	86年	87年	販賣高(百万弗)	
	順位	順位	86年	87年
N E C	1	1	2,638	3,193
도시바	3	2	2,276	2,939
히타찌	2	3	2,307	2,781
모토로라	4	4	2,025	2,450
TI	5	5	1,781	2,125
후지쯔	6	6	1,365	1,899
필립스-시그네틱스	8	7	1,258	1,597
인텔	11	8	991	1,500
미쓰비시	10	9	1,136	1,481
마쓰시타	9	10	1,206	1,479

資料：Dataquest 88. 1

있었고 主要業体 대부분이 종합 메이커인 관계로 社内 各 部門間의 有機的인 연계를 通한 利点을 살릴 수 있었기 때문이다.

이와 동시에, 日本政府의 지원도 業体에 큰 도움이 되었다. 즉, 日本政府는 이미 70年代부터 美国을 겨냥하여 대규모 政府支援 研究開発事業을 수행해 왔으며, 日本電話通信公社(NTT)는 大量 発注를 통해 半導体 業界의 성장을 도왔다. 사실, 日本의 半導体 業界의 성장은 이러한 지원 속에서 이루어졌다고 해도 과언은 아니다.

이러한 成長을 배경으로 日本 業体는 美国 市場을 본격적으로 장악하게 되었는데, 日本의 対美 IC 製品 貿易 収支를 보면 이러한 市場變化를 확실히 알 수 있다. (表 2 參照)

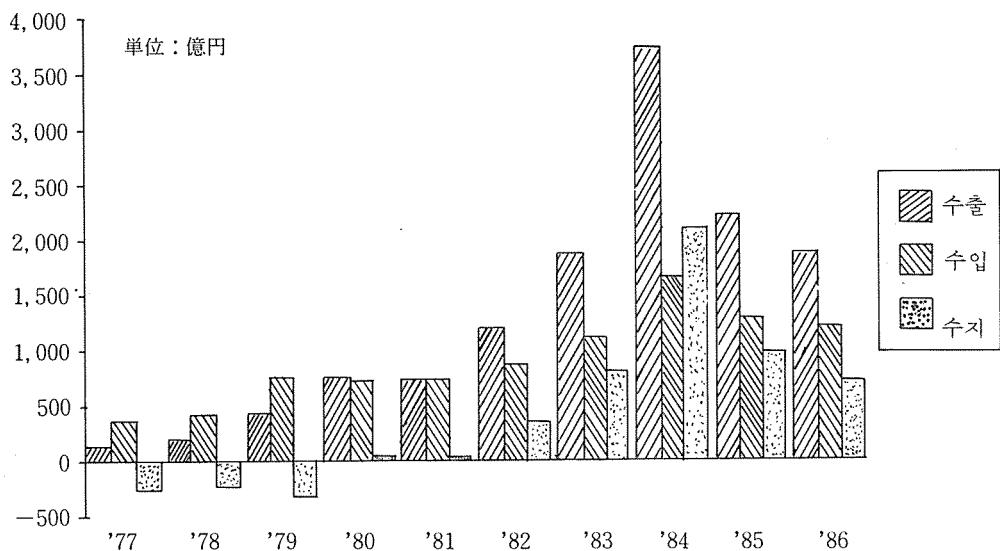


表2. 日本의 對美 IC 貿易 収支

年 度	對美輸出	對美輸入	貿易収支
77	103	356	△ 253
78	174	407	△ 233
79	418	741	△ 323
80	724	696	28
81	712	705	7
82	1,168	835	333
83	1,843	1,076	767
84	3,722	1,636	2,086
85	2,194	1,252	942
86	1,859	1,176	683

資料：日本野村總合研、「財界観測」, 86. 5

이에 따르면, 79년까지 美国이 黑字를 유지하던 IC 貿易収支가 80년부터는 日本의 黑字로逆転되었고, 82년부터는 그 폭이 크게 확대되어 84년에 무려 2,086억엔의 黑字를 나타내고 있음을 알 수 있다. 85~86년의 黑字 減小는 당시景氣不況에 따른 일시적인 현상으로 생각된다.

결국, 日本製 半導体의 對美 輸出 急增은 美国業体의 経営悪化와 이에 따른 연쇄도산을誘發하였으며, 이에 대응한 美国 SIA (Semiconductor Industry Association : 美国半導体工業協會)의 덤핑 提訴가 美·日 半導体 摩擦을 본

격적으로 불붙인 것이다. 당시(85年 6月), SIA가 美通商代表部에 提訴한 이유는 "日本의 半導体 輸出이 生産原価 이하에서 이루어져, 市場秩序를 교란하고 있고, 特히 日本市場을 폐쇄하여 外國產 半導体의 市場占有率을 의도적으로 낮추므로써 不公正行為를 하고 있다는 것"이다.

## 2. 摩擦 그 以後

美·日間의 半導体 摩擦은 앞서 언급한 바와 같이, 美国의 市場主導権 상실에 기인한 것이나 그 배경이 美国의 尖端產業分野에서의 競争力 약화에 대한 우려감과 技術開發力의 劣勢에서 파생된 것임은 쉽게 생각할 수 있다.

半導体 產業은 자체의 重要性뿐 아니라 家電, 通信機器, 宇宙航空, 로보트 및 컴퓨터 分野의 根幹이 되는 核心產業이기 때문으로, 美国의 입장 - 다른 国家도 마찬가지겠으나 -에서는 절대적인 優位를 확보해야 하기 때문이다.

따라서, 半導体 摩擦은 半導体 產業에서의 主導権을 日本에게 완전히 빼앗기기 前에 美国 產業을 활성화하여 國際競爭力を 提高시키고, 궁극적으로는 尖端分野에서의 시장점유율을 회복을 위해 예견되었던 조치였다고 할 수 있다.

사실, 美国의 對外國 貿易摩擦은 日本과의 半

導体摩擦 이후에도 각종 형태로 빈번하게 나타났다. 그중 하나가 美行政府의 日本電子製品에 加한 100% 報復關稅 부과조치였다. 당시 美行政府는 日本이 半導体摩擦 후 체결한 半導体協定을 준수하고 있지 않다는 이유로, 이와 같은 強更策을 사용하였는데, 보복대상은 半導体와 이를 사용한 제품까지 포함하였다. 輸入半導体에 대한 美關稅率이 3 ~ 7 % 정도인 것에 비해, 100%의 報復關稅率은 유례가 없는 조치로서 半導体産業을 향한 美国의 의지를 보여주는 사案이라 하겠다.

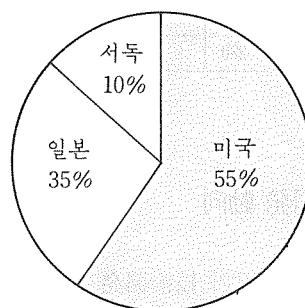
또한, 年前의 三星 - TI의 特許紛爭도 美貿易장벽의 한 단면이라고 하겠다. 우리나라의 技術水準과 半導体産業의 後發性을 고려할 때, 日本에 이은 韓·美 半導体摩擦이라기보다는, 일방적으로 로열티를 강요당한 사案이었지만 이 역시 美·日 半導体摩擦의 연장이라고 생각된다.

그런데, 이와 같은 美国의 각종 報復措置와 外國과의 摩擦을 불사하고 立法을 강행하는 保護法案은 半導体와 같은 尖端分野에서의 技術力 퇴조가 근원임은 확실하다. 이미 美国이 그러한 징후를 나타내고 있음은 최근의 여러 사례에서 알 수 있는데, 특히 企業의 創意性과 未來發展性의 重要尺度라고 할 수 있는 特許取得件数를 보면 분명해진다.

하이테크 產業分野에서는 技術開發力과 保有 技術力이 企業優劣을 결정하는 지표로서, 企業의 重要資產인 技術을 보호할 수 있고, 独占化하여 높은 수익을 보장할 수 있으며, 研究開發에 投資한 비용을 환수할 수 있는 特許 매니지먼트는 중요한 企業戰略으로 간주되고 있다. 그런데, 최근의 特許現況을 보면 美国의 重要企業들은 日本企業들에게 뒤쳐지고 있으며, 그 격차는 커지고 있는 실정이다. 참고로 表3의 美国内 特許取得 上位 20個 企業의 面面을 보면, 日本企業가 7個나 포함되어 있으나 美国企業는 自國임에도 불구하고 順位가 떨어지고 있다. 이것을 보면, 表3의 特許取得件이 半導体 등 尖端技術만의 特許를 의미하지는 않으나, 美·日間의 전반적인 技術力を 짐작하게 한다.

이렇게 美·日 半導体摩擦 以後 両국은 市場爭奪과 技術優位를 위한 마찰과 競争을 계속 해왔으며, 半導体分野에서의 그것은 더욱 치열하게 展開되어 왔다.

국가별 업체구성비



국가별 특허건수 구성비

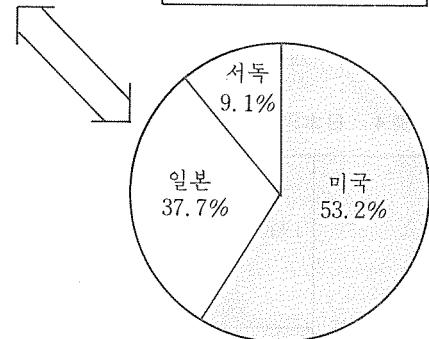


表3. 美國內 特許取得件數 上位20業體

業體	取得順位		86年件數 (86件數)	86年 R&D 投資(M\$)	売出對比 R&D比率
	85年	86年			
허다찌	2	1	730	1,332.0	5.9
G E	1	2	713	3,300.0	9.4
도시바	3	3	691	860.6	5.6
I BM	4	4	597	5,200.0	10.1
캐논	7	5	522	139.9	9.7
필립스(北美)	5	6	503	113.5	2.5
R C A	6	7	484	(GE社 참조)	
후지 Photo	10	8	446	246.0	5.8
Siemens	8	9	409	2,486.8	11.5
Westinghouse	11	10	398	918.0	8.6
Bayer-Welt	13	11	389	955.1	5.1
Dow Chemical	16	12	369	605.0	5.4
미쓰비시	12	13	358	474.9	5.0

業體	取得順位		'86件数	86年 R&D 投資(M\$)	売出對比 R&D比率
	85年	86年			
Mobil Oil	14	14	337	215.0	0.5
モトローラ	28	15	333	492.0	8.4
Du Pont	15	16	325	1,156.0	4.3
AT & T-Bell Lab	9	17	322	2,100.0	6.2
GM	23	18	293	6,215.5	6.0
혼다	19	19	280	508.3	3.8
Nissan	17	19	280	770.0	4.5

資料 : Economist 87. 5. 9

### 3. 最近의 技術開發 動向

최근의 各国, 各業體에서의 技術開發 活動은 매우 치열하게 진행되고 있다. 특히, 半導体産業 分野의 研究活動은 戰爭을 방불케 할 정도로 극심하여, 새로운 방법, 새로운 차원의 新技術

表 4. 日本의 超高集積寨子 開發日程 (豫想)

4M DRAM	1世代(試製品)	/ / / /																								
		ES QS CS																								
16M DRAM	2世代(改良品)	/ / / /																								
		ES QS CS																								
	1世代(試製品)	/ / / /																								
		ES QS CS																								
日程(分期)		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		'87		'88		'89		'90		'91		'92		'93												

註 : ES : Test Sample

QS : 製品認定用

CS : 製品實驗使用

資料 : Nikkei Microdevices.

이 속속 등장하고 있다.

美國의 경우, 침체 수렁에 빠진 美半導体 産業의 회생과 技術力 회복을 위해 前例없던 研究共同体를 구성하였는데, 이는 美行政府의 特別資金 支援과 反獨禁法例外認定에 따라 美業체들이 콘소시엄을 결성한 것으로, 앞으로 政府次元의 계속적인 支援이 있을 것으로 예상된다. 이제 美·日이 경합을 벌여온 市場主導權 다툼이 両국間의 貿易摩擦이라는 영역을 넘어, 汎国家的인 次元으로 發展되었음을 나타낸다고 하겠다.

이 美国 半導体 技術研究콘소시엄은 「SEMA-TECH」로 명명되었는바, 13個 業체로 구성되어 있으며, 研究費로만 10억弗 이상을 投資하여 新技術開發의 産室과 尖端 半導体 工場으로서의 역할을 계획하고 있다.

日本도 축적된 技術을 토대로 研究開發分野에 총력을 경주하고 있다. 이미 부분적으로는

美国을 추월하고 있지만, 최근 발표된 바에 따르면, 日本은 엔하와 각국의 견제를 극복하고 90年代 세계 최고의 기술력을 확보하기 위해 「JAPANTECH」라는 연구 프로젝트의 구상을 밝혔으며, 더욱 놀라운 것은 이미 80年度에 日通産省이 발표한 「Technopolis Concept」에 의한 계획이다. 이 프로젝트는 日本全域에 美 실리콘 벨리와 日쓰꾸바 科学団地를 모델로 한 기술产业地帯를 26개나 설치하고, 한개 地帯마다 10~20억弗의 开発費用을 支援하는 것으로, 그 규모와 日本의 未来指向의 계획을 엿볼 수 있다.

이와 같은 研究計劃 수립은 日本이 기술革新을 바탕으로 한 新기술 开発과 研究活性化가 外国, 특히 우리나라를 비롯한 「NICS」의猛烈한 추격을 따돌리고 競争力を 恒久的으로 유지시킬 수 있는 방도라고 인식했기 때문이다. 이를 통해 일본은 半導体 各分野에서 더욱 위력을 보일 것으로 생각된다.

今年初, 히다찌, 마쓰시다, 도시바의 日本 3

社가 발표한 16M DRAM은 바로 日本의 技術先導를 확실히 알 수 있는 좌표였다. 表 4에 日本의 超高集積素子 开発日程을 図示한 바와 같이, 90年代 情報通信 시스템 分野에서 중추 役割을 담당할 16M DRAM의 开發成功으로 앞으로의 市場現況을 예상하게 하고 있다.

우리나라의 경우, 今年初 4M DRAM 开發에 성공한 바 있고, 계속 量產技術研究를 進行하고 있지만 현재와 같은 美·日의 研究開發現况을 볼 때, 더욱 더 技術開發에 힘을 쏟아야 할 것으로 판단된다.

앞서 전술된 바와 같이, 美·日 半導体 摩擦, 貿易紛爭, 特許訴訟과 같은 事例들은 技術力이 수반되지 않고는 우리의 半導体産業 成長이 기대될 수 없음을 強하게 示唆하고 있기 때문이다.

그러나 이와 같은 半導体 技術開發이 단숨에 이루어지기는 힘든 과정이므로, 앞으로도 현재 推進中인 프로젝트를 포함, 業体間·産學間·官民間의 협조관계를 強化해 나아가야 한다고 생각한다.

